

2017-2022年中国集成电路行业市场深度调查及发展前景预测报告

报告大纲

一、报告简介

华经情报网发布的《2017-2022年中国集成电路行业市场深度调查及发展前景预测报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.huaon.com/detail/303163.html>

报告价格：电子版: 9000元 纸介版：9000元 电子和纸介版: 9200元

订购电话: 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱: kf@huaon.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

集成电路（integrated circuit）是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构；其中所有元件在结构上已组成一个整体，使电子元件向着微小型化、低功耗、智能化和高可靠性方面迈进了一大步。它在电路中用字母“IC”表示。集成电路发明者为杰克·基尔比（基于锗（Ge）的集成电路）和罗伯特·诺伊思（基于硅（Si）的集成电路）。当今半导体工业大多数应用的是基于硅的集成电路。

是20世纪50年代后期—60年代发展起来的一种新型半导体器件。它是经过氧化、光刻、扩散、外延、蒸铝等半导体制造工艺，把构成具有一定功能的电路所需的半导体、电阻、电容等元件及它们之间的连接导线全部集成在一小块硅片上，然后焊接封装在一个管壳内的电子器件。其封装外壳有圆壳式、扁平式或双列直插式等多种形式。集成电路技术包括芯片制造技术与设计技术，主要体现在加工设备，加工工艺，封装测试，批量生产及设计创新的能力上。

我国电子产业发展相较美、日、韩和台湾地区发展较晚，发展方式多从低端业务做起，没有得到发达国家的技术转移，因此发展较为滞后。尽管诸多不利因素，我国电子产业仍然保持较高增长态势，根据工信部的统计我国集成电路在最近10年增速较快，10年时间增长接近250%，10年复合增长率高达15%，尤其是2008年金融危机后维持在20%左右增速。

2006-2015年我国集成电路产值规模（亿元）

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 集成电路行业发展综述26

第一节 集成电路行业概述26

一、集成电路的概念26

二、集成电路的特点26

三、集成电路的分类27

第二节 中国集成电路行业政策环境30

一、集成电路行业监管体制30

二、集成电路行业政策综述	30
三、集成电路行业财税政策	32
四、集成电路业投融资政策	33
五、集成电路研究开发政策	34
六、集成电路业进出口政策	35
七、集成电路行业人才政策	35
八、集成电路知识产权政策	36
第三节 世界集成电路行业发展分析	36
一、世界集成电路产业发展态势	36
(一) 世界集成电路产业发展概述	36
2015 全球Top10 集成电路设计企业销售额	
(二) 世界集成电路产业区域格局	37
(三) 世界集成电路产业市场规模	38
(四) 世界集成电路产业商业模式	40
二、美国集成电路产业发展分析	41
(一) 美国集成电路产业发展概况	41
(二) 美国集成电路产业空间布局	42
(三) 美国集成电路产业发展模式	42
三、欧洲集成电路产业发展分析	43
(一) 欧洲集成电路产业发展概况	43
(二) 欧洲集成电路产业空间布局	43
(三) 欧洲集成电路产业发展模式	44
四、日本集成电路产业发展分析	45
(一) 日本集成电路产业发展概况	45
(二) 日本集成电路产业空间布局	46
(三) 日本集成电路产业发展模式	47
五、韩国集成电路产业发展分析	47
(一) 韩国集成电路产业发展概况	47
(二) 韩国集成电路产业空间布局	48
(三) 韩国集成电路产业发展模式	48
六、台湾集成电路产业发展分析	49
(一) 台湾集成电路产业发展概况	49
(二) 台湾集成电路产业空间布局	50
(三) 台湾集成电路产业发展模式	51
第二章 中国集成电路行业产业链分析	53

第一节 集成电路设计行业发展分析53

一、集成电路设计行业发展概述53

国内IC 测试封装企业通过自身进步发展加上外延并购，目前已经掌握了全球先进的测试封装技术并形成了一定规模，长电科技已经跻身全球前十大集成电路封装测试企业。同时，近年来在国家政策资金支持和市场需求的推动下，国内IC 设计领域发展快速崛起，IC 设计产值占比已经从2006 年的19%提升到2015 年的37%，并且培育出了海思和展讯这样全球领先的IC 设计企业。

2006-2015 中国集成电路行业分领域销售结构

二、集成电路设计行业特点分析55

三、集成电路设计行业经营模式56

四、集成电路设计行业发展规模57

五、集成电路设计行业竞争格局58

（一）行业主要企业竞争态势58

（二）上游产业对行业的影响59

（三）下游产业对行业的影响59

六、集成电路设计业SWOT分析60

第二节 集成电路制造行业发展分析60

一、集成电路制造行业发展概述60

二、集成电路制造发展瓶颈分析62

三、集成电路制造行业发展规模62

四、集成电路制造行业竞争格局63

（一）行业主要企业竞争态势63

（二）上游产业对行业的影响64

（三）下游产业对行业的影响64

五、集成电路制造业SWOT分析64

第三节 集成电路封测行业发展分析65

一、集成电路封测行业发展概述65

二、集成电路封测行业经营模式66

三、集成电路封测行业发展规模67

四、集成电路封测行业竞争格局68

（一）国内外企业间竞争态势68

（二）上游产业对行业的影响69

（三）下游产业对行业的影响69

五、集成电路封测业SWOT分析69

六、集成电路封装细分行业分析70

- (一) BGA封装市场分析70
- (二) SIP封装市场分析71
- (三) SOP封装市场分析72
- (四) QFP封装市场分析72
- (五) QFN封装市场分析73
- (六) MCM封装市场分析74
- (七) CSP封装市场分析75
- (八) 晶圆级封装市场分析77
- (九) 覆晶/倒封装市场分析78
- (十) 3D封装市场分析80

第三章 2009-2016年中国集成电路行业发展态势81

第一节 2012-2016年集成电路行业发展分析81

- 一、2012年集成电路行业发展概况81
- 二、2016年集成电路行业发展概况83

第二节 2009-2016年集成电路行业规模分析85

- 一、集成电路行业企业数量分析85
- 二、集成电路行业资产规模分析88
- 三、集成电路行业销售收入分析91
- 四、集成电路行业利润总额分析94

第三节 2009-2016年集成电路行业效益分析97

- 一、集成电路行业盈利能力分析97
- 二、集成电路行业的毛利率分析101
- 三、集成电路行业运营能力分析103
- 四、集成电路行业偿债能力分析107

第四节 集成电路行业结构特征分析110

- 一、集成电路企业经济类型分析110
 - (一) 国有集成电路企业经济指标分析110
 - (二) 股份制集成电路企业的经济指标111
 - (三) 股份合作集成电路企业经济指标112
 - (四) 私营集成电路企业经济指标分析113
 - (五) 外资集成电路企业经济指标分析114
- 二、集成电路企业规模结构分析116

(一) 大型集成电路企业经济指标分析	116
(二) 中型集成电路企业经济指标分析	117
(三) 小型集成电路企业经济指标分析	118
三、集成电路行业分地区发展分析	119
(一) 东北地区集成电路行业发展分析	119
(二) 华北地区集成电路行业发展分析	120
(三) 华东地区集成电路行业发展分析	121
(四) 华南地区集成电路行业发展分析	122
(五) 华中地区集成电路行业发展分析	123
(六) 西南地区集成电路行业发展分析	124
(七) 西北地区集成电路行业发展分析	125
第四章 2008-2016年中国集成电路市场运行分析	127
第一节 2008-2016年集成电路供需市场分析	127
一、集成电路市场发展概述	127
二、集成电路供给市场分析	128
(一) 集成电路供给市场现状	128
(二) 集成电路产量规模分析	129
(三) 集成电路的生产集中度	130
三、集成电路需求市场分析	131
(一) 集成电路需求市场现状	131
(二) 集成电路市场规模分析	132
(三) 集成电路需求结构分析	132
第二节 2009-2016年集成电路进出口分析	135
一、2009-2016年集成电路进口情况	135
(一) 集成电路进口数量情况	135
(二) 集成电路进口金额分析	135
(三) 集成电路进口来源分析	135
(四) 集成电路进口价格分析	137
二、2009-2016年集成电路出口情况	137
(一) 集成电路出口数量情况	137
(二) 集成电路出口金额分析	138
(三) 集成电路出口流向分析	138
(四) 集成电路出口价格分析	140
第三节 集成电路产业知识产权分析	140
一、集成电路产业知识产权综述	140

（一）集成电路知识产权特点分析140

（二）集成电路产业专利申请规模142

二、集成电路产业设计类专利分析142

（一）设计类专利申请规模142

（二）专利申请国家及地区143

（三）IPC技术分类的趋势148

（四）主要权利人分布情况152

三、集成电路产业制造类专利分析155

（一）制造类专利申请规模155

（二）专利申请国家及地区155

（三）IPC技术分类的趋势156

（四）主要权利人分布情况157

四、集成电路产业封装类专利分析158

（一）封装类专利申请规模158

（二）专利申请国家及地区158

（三）IPC技术分类的趋势159

（四）主要权利人分布情况160

五、集成电路产业测试类专利分析161

（一）测试类专利申请规模161

（二）专利申请国家及地区161

（三）IPC技术分类的趋势162

（四）主要权利人分布情况162

六、集成电路布图设计专有权分析163

（一）集成电路布图设计申请规模163

（二）集成电路布图设计省市排名164

（三）布图设计专有权的产品分析164

（四）布图设计国内外权利人分析165

第五章 中国集成电路相关元件市场分析167

第一节 电容器167

一、电容器市场发展分析167

（一）电容器市场发展概况167

（二）电容器市场供需分析168

（三）电容器市场竞争格局168

二、电容器价格行情分析170

（一）电容器价格走势分析170

（二）电容器价格前景预测170

三、电容器市场前景及趋势171

第二节 电感器171

一、电感器市场发展分析171

（一）电感器市场发展概况171

（二）电感器市场供需分析172

（三）电感器市场竞争格局173

二、电感器价格行情分析174

（一）电感器价格走势分析174

（二）电感器价格前景预测174

三、电感器市场前景及趋势175

第三节 电阻器176

一、电阻器市场发展分析176

（一）电阻器市场发展概况176

（二）电阻器市场供需分析177

（三）电阻器市场竞争格局178

二、电阻器价格行情分析178

（一）电阻器价格走势分析178

（二）电阻器价格前景预测179

三、电阻器市场前景及趋势179

第四节 晶体管180

一、晶体管市场发展分析180

（一）晶体管市场发展概况180

（二）晶体管市场供需分析181

（三）晶体管市场竞争格局182

二、晶体管价格行情分析183

（一）晶体管价格走势分析183

（二）晶体管价格前景预测183

三、晶体管技术研发分析183

第五节 二极管184

一、二极管市场发展分析184

（一）二极管市场发展概况184

（二）二极管市场供需分析185

（三）二极管市场竞争格局186

二、二极管价格行情分析187

（一）二极管价格走势分析187

（二）二极管价格前景预测188

三、二极管市场前景及趋势188

第六章 中国集成电路应用领域发展分析190

第一节 计算机领域集成电路市场分析190

一、计算机产业市场发展态势190

（一）计算机行业发展基本情况190

（二）计算机产品产销情况分析191

（三）计算机行业发展规划分析192

二、计算机集成电路市场分析193

（一）计算机类集成电路需求特点193

（二）计算机类集成电路市场规模193

（三）计算机类集成电路竞争格局194

第二节 汽车电子类集成电路市场分析194

一、汽车电子市场发展态势分析194

（一）汽车市场产销情况分析194

（二）汽车电子市场规模分析196

（三）汽车电子市场应用结构197

（四）汽车电子市场产品结构197

二、汽车电子集成电路市场分析198

（一）汽车电子类集成电路市场特点198

（二）汽车电子类集成电路市场规模200

（三）汽车电子类集成电路应用结构200

（四）汽车电子类集成电路产品结构201

（五）汽车电子类集成电路品牌份额202

第三节 消费电子类集成电路市场分析203

一、消费电子行业发展态势分析203

（一）消费电子行业发展概况203

（二）消费电子产品产销规模203

（三）消费电子需求潜力分析205

二、消费电子集成电路市场分析206

（一）消费电子类集成电路市场特点206

（二）消费电子类集成电路市场规模207

（三）消费电子类集成电路应用市场207

- (四) 消费电子类集成电路竞争格局208
- 第四节 网络通信类集成电路市场分析209
 - 一、网络通信行业发展态势分析209
 - (一) 网络通信行业发展概况209
 - (二) 网络通信设备市场分析210
 - (三) 网络通信设备需求潜力211
 - 二、网络通信集成电路市场分析211
 - (一) 网络通信类集成电路市场特点211
 - (二) 网络通信类集成电路市场规模212
 - (三) 网络通信类集成电路应用市场212
- 第五节 工业控制类集成电路市场分析213
 - 一、工业控制行业发展态势分析213
 - (一) 工业控制行业发展概述213
 - (二) 工业控制设备产销分析214
 - (三) 工业控制设备需求潜力216
 - 二、工业控制类集成电路市场分析217
 - (一) 工业控制类集成电路市场特点217
 - (二) 工业控制类集成电路市场规模217
 - (三) 工业控制类集成电路应用市场218
 - (四) 工业控制类集成电路竞争格局218

第七章 中国集成电路行业区域发展分析219

第一节 集成电路产业区域总体格局219

- 一、集成电路产业区域分布特点219
- 二、“一轴一带”竞争格局分析219
- 三、集成电路设计产业区域分布220
- 四、集成电路制造产业区域分布220
- 五、集成电路封测产业区域分布221

第二节 环渤海集成电路产业分析221

- 一、环渤海集成电路产业概述221
 - (一) 环渤海集成电路业现状221
 - (二) 集成电路行业竞争格局222
 - (三) 集成电路行业市场规模222
- 二、环渤海集成电路SWOT分析222
 - (一) 产业发展优势分析222

- (二) 产业发展劣势分析223
- (三) 产业发展机会分析223
- (四) 产业发展威胁分析223
- 三、北京地区集成电路行业分析224
 - (一) 集成电路行业发展概述224
 - (二) 集成电路行业供给规模225
 - (三) 集成电路产业发展布局225
 - (四) 集成电路产业政策规划226
- 四、天津地区集成电路行业分析226
 - (一) 集成电路行业发展概述226
 - (二) 集成电路行业供给规模227
 - (三) 集成电路产业发展布局227
 - (四) 集成电路产业政策规划228
- 五、山东地区集成电路行业分析228
 - (一) 集成电路行业发展概述228
 - (二) 集成电路行业供给规模230
 - (三) 集成电路产业发展布局230
 - (四) 集成电路产业政策规划231
- 第三节 长三角集成电路产业分析231
 - 一、长三角集成电路产业概述231
 - (一) 长三角集成电路业现状231
 - (二) 集成电路行业竞争格局232
 - (三) 集成电路行业市场规模233
 - 二、长三角集成电路SWOT分析233
 - (一) 产业发展优势分析233
 - (二) 产业发展劣势分析234
 - (三) 产业发展机会分析234
 - (四) 产业发展威胁分析235
 - 三、上海地区集成电路行业分析236
 - (一) 集成电路行业发展概述236
 - (二) 集成电路行业供给规模237
 - (三) 集成电路产业发展布局237
 - (四) 集成电路产业政策规划238
 - 四、江苏地区集成电路行业分析242
 - (一) 集成电路行业发展概述242

(二) 集成电路行业供给规模	243
(三) 集成电路产业发展布局	243
(四) 集成电路产业政策规划	244
五、浙江地区集成电路行业分析	245
(一) 集成电路行业发展概述	245
(二) 集成电路行业供给规模	246
(三) 集成电路产业发展布局	246
(四) 集成电路产业政策规划	247
第四节 珠三角集成电路产业分析	248
一、珠三角集成电路产业概述	248
(一) 珠三角集成电路业现状	248
(二) 集成电路行业竞争格局	248
(三) 集成电路行业市场规模	249
二、珠三角集成电路SWOT分析	249
(一) 产业发展优势分析	249
(二) 产业发展劣势分析	250
(三) 产业发展机会分析	250
(四) 产业发展威胁分析	250
三、广东地区集成电路行业分析	251
(一) 集成电路行业发展概述	251
(二) 集成电路行业供给规模	252
(三) 广东集成电路产业布局	252
(四) 集成电路产业政策规划	253
第五节 集成电路潜力城市发展分析	254
一、大连集成电路产业分析	254
二、合肥集成电路产业分析	254
三、厦门集成电路产业分析	255
四、武汉集成电路产业分析	256
五、重庆集成电路产业分析	257
六、成都集成电路产业分析	258
七、西安集成电路产业分析	259
第八章 中国集成电路行业重点企业竞争力分析	262
第一节 国际集成电路企业竞争力分析	262
一、Intel（英特尔）	262
(一) 企业经营情况分析	262

- (二) 集成电路产品分析262
- (三) 集成电路应用领域263
- (四) 企业SWOT分析263
- 二、Samsung（三星） 264
 - (一) 企业经营情况分析264
 - (二) 集成电路产品分析264
 - (三) 集成电路应用领域265
 - (四) 企业SWOT分析265
- 三、Hynix（海力士） 266
 - (一) 企业经营情况分析266
 - (二) 集成电路产品分析266
 - (三) 集成电路应用领域266
 - (四) 企业SWOT分析267
- 四、TI（德州仪器） 267
 - (一) 企业经营情况分析267
 - (二) 集成电路产品分析268
 - (三) 集成电路应用领域268
 - (四) 企业SWOT分析269
- 五、AMD（超微） 269
 - (一) 企业经营情况分析269
 - (二) 集成电路产品分析269
 - (三) 集成电路应用领域270
 - (四) 企业SWOT分析270
- 六、Toshiba（东芝） 271
 - (一) 企业经营情况分析271
 - (二) 集成电路产品分析271
 - (三) 集成电路应用领域271
 - (四) 企业SWOT分析272
- 七、ST（意法半导体） 272
 - (一) 企业经营情况分析272
 - (二) 集成电路产品分析273
 - (三) 集成电路应用领域273
 - (四) 企业SWOT分析273
- 八、NXP（恩智浦） 274
 - (一) 企业经营情况分析274

(二) 集成电路产品分析274

(三) 集成电路应用领域274

(四) 企业SWOT分析275

九、Freescale（飞思卡尔） 275

(一) 企业经营情况分析275

(二) 集成电路产品分析276

(三) 集成电路应用领域276

(四) 企业SWOT分析276

十、Renesas（瑞萨） 277

(一) 企业经营情况分析277

(二) 集成电路产品分析277

(三) 集成电路应用领域277

(四) 企业SWOT分析277

十一、MTK（联发科） 278

(一) 企业基本情况278

(二) 集成电路产品分析278

(三) 集成电路应用领域278

(四) 企业发展目标分析279

第二节 中国大陆集成电路企业竞争力分析279

一、中芯国际集成电路制造有限公司279

(一) 企业发展基本情况279

(二) 企业经营情况分析280

(三) 企业经济指标分析280

(四) 企业盈利能力分析281

(五) 企业偿债能力分析281

(六) 企业运营能力分析281

(七) 企业成本费用分析282

二、中电广通股份有限公司282

(一) 企业基本情况282

(二) 企业经营情况分析283

(三) 企业经济指标分析284

(四) 企业盈利能力分析285

(五) 企业偿债能力分析285

(六) 企业运营能力分析286

(七) 企业成本费用分析286

三、北京君正集成电路股份有限公司287

- (一) 企业基本情况287
- (二) 企业经营情况分析287
- (三) 企业经济指标分析289
- (四) 企业盈利能力分析289
- (五) 企业偿债能力分析290
- (六) 企业运营能力分析290
- (七) 企业成本费用分析290

四、北京福星晓程电子科技股份有限公司291

- (一) 企业基本情况291
- (二) 企业经营情况分析291
- (三) 企业经济指标分析293
- (四) 企业盈利能力分析293
- (五) 企业偿债能力分析294
- (六) 企业运营能力分析294
- (七) 企业成本费用分析295

五、天水华天科技股份有限公司295

- (一) 企业基本情况295
- (二) 企业经营情况分析295
- (三) 企业经济指标分析296
- (四) 企业盈利能力分析296
- (五) 企业偿债能力分析297
- (六) 企业运营能力分析297
- (七) 企业成本费用分析298

六、江苏长电科技股份有限公司298

- (一) 企业基本情况298
- (二) 企业经营情况分析299
- (三) 企业经济指标分析300
- (四) 企业盈利能力分析300
- (五) 企业偿债能力分析301
- (六) 企业运营能力分析301
- (七) 企业成本费用分析301

七、苏州晶方半导体科技股份有限公司302

- (一) 企业基本情况302
- (二) 企业经济指标分析303

(三) 企业偿债能力分析303

(四) 企业运营能力分析304

(五) 企业成本费用分析304

八、杭州士兰微电子股份有限公司305

(一) 企业基本情况305

(二) 企业经营情况分析305

(三) 企业经济指标分析306

(四) 企业盈利能力分析307

(五) 企业偿债能力分析307

(六) 企业运营能力分析308

(七) 企业成本费用分析308

九、中颖电子股份有限公司309

(一) 企业基本情况309

(二) 企业经营情况分析309

(三) 企业经济指标分析311

(四) 企业盈利能力分析311

(五) 企业偿债能力分析311

(六) 企业运营能力分析312

(七) 企业成本费用分析312

十、上海贝岭股份有限公司313

(一) 企业基本情况313

(二) 企业经营情况分析313

(三) 企业经济指标分析314

(四) 企业盈利能力分析315

(五) 企业偿债能力分析315

(六) 企业运营能力分析315

(七) 企业成本费用分析316

十一、南通富士通微电子股份有限公司316

(一) 企业基本情况316

(二) 企业经营情况分析317

(三) 企业经济指标分析317

(四) 企业盈利能力分析318

(五) 企业偿债能力分析318

(六) 企业运营能力分析319

(七) 企业成本费用分析319

十二、吉林华微电子股份有限公司320

- (一) 企业基本情况320
- (二) 企业经营情况分析320
- (三) 企业经济指标分析322
- (四) 企业盈利能力分析322
- (五) 企业偿债能力分析322
- (六) 企业运营能力分析323
- (七) 企业成本费用分析323

第九章 集成电路企业融资并购与转型升级战略分析325

第一节 集成电路企业融资渠道与选择分析325

- 一、集成电路企业融资方法与渠道简析325
- 二、利用股权融资谋划企业发展机遇327
- 三、利用政府杠杆拓展企业融资渠道331
- 四、适度债权融资配置自身资本结构332
- 五、关注民间资本和外资的投资动向333

第二节 集成电路企业股权融资分析334

- 一、集成电路企业股权融资概述334
 - (一) 集成电路股权融资概况334
 - (二) 股权融资细分领域分布334
 - (三) 股权融资企业区域分布335
- 二、集成电路企业股权融资方式336
 - (一) VC/PE股权融资分析336
 - (二) 战略投资方式分析337
- 三、股权融资典型案例分析337

第三节 集成电路企业并购市场分析338

- 一、集成电路企业并购市场概述338
 - (一) 集成电路企业并购概况338
 - (二) 企业并购细分领域分布338
 - (三) 参与并购企业区域分布339
- 二、集成电路并购企业特性分析340
 - (一) 集成电路企业并购模式340
 - (二) 集成电路企业并购问题341
- 三、集成电路企业并购案例分析341

第四节 集成电路企业转型升级战略分析342

一、集成电路企业转型升级背景分析342

- (一) 经济增长结构转型客观要求342
- (二) 信息化为转型升级提供契机342
- (三) 集成电路企业融资环境紧张343
- (四) 企业人力资源成本持续上升344
- (五) 企业风险控制能力渐显不足344

二、集成电路企业转型升级模式分析345

- (一) 企业转型升级主要模式345
- (二) 企业产业延伸模式分析346
- (三) 企业兼并重组模式分析346
- (四) 企业海外扩张模式分析347

三、集成电路企业转型升级路径分析348

- (一) 打造自主品牌转型路径348
- (二) 从制造向设计服务转型349
- (三) 从低端向高端升级路径350
- (四) 精细化管理转型升级路径351
- (五) 产业链资源整合转型升级352

四、集成电路企业转型升级策略分析353

- (一) 企业向差异化战略转变353
- (二) 走向注重质量提升转变354
- (三) 向重视可持续发展转变354
- (四) 从竞争向合作共赢转变355
- (五) 向高层次国际运营转变355

第十章 2017-2022年中国集成电路行业投资前景及转型升级分析357

第一节 2017-2022年集成电路行业前景分析357

一、集成电路业“十二五”规划解读357

- (一) 集成电路产业链完善方向357
- (二) 集成电路设计业发展规划357
- (三) 集成电路制造业发展规划359
- (四) 集成电路封测业发展规划359

二、集成电路产业发展目标及前景分析360

- (一) 集成电路产业技术创新目标360
- (二) 集成电路产业结构目标分析360
- (三) 集成电路企业竞争格局展望360

(四) 集成电路区域竞争格局展望360

三、集成电路产业需求领域前景分析361

(一) 计算机产业需求前景分析361

(二) 消费电子产业需求前景分析362

(三) 网络通信产业需求前景分析362

(四) 汽车电子产业需求前景分析363

(五) 工业控制行业需求前景分析364

(六) 其他潜力领域需求前景分析365

四、集成电路产业发展规模预测分析365

(一) 集成电路产业市场规模预测365

(二) 集成电路设计产业规模预测366

(三) 集成电路制造产业规模预测367

(四) 集成电路封测产业规模预测367

第二节 2017-2022年集成电路行业投资分析368

一、集成电路行业投资壁垒分析368

(一) 技术壁垒分析368

(二) 人才壁垒分析369

(三) 资金壁垒分析369

二、集成电路行业投资风险分析369

(一) 宏观经济风险369

(二) 产品开发风险369

(三) 市场竞争风险370

(四) 技术淘汰风险370

三、集成电路行业投资策略分析370

第十一章 中国集成电路企业IPO市场及上市策略分析372

第一节 集成电路企业IPO市场分析372

一、集成电路企业IPO情况概述372

(一) 集成电路IPO概况372

(二) IPO细分领域分布373

(三) IPO企业区域分布373

(四) 募投项目分布情况374

二、集成电路IPO企业特征分析375

(一) 集成电路企业IPO领域特征375

(二) 集成电路企业IPO上市地分布376

(三) 集成电路企业IPO区域分布376

三、集成电路企业IPO案例分析377

第二节 集成电路企业境内IPO上市目的及条件378

一、企业境内上市主要目的378

二、企业上市需满足的条件379

三、企业改制上市中的关键问题383

第三节 集成电路企业IPO上市的相关准备383

一、企业该不该上市383

二、企业应何时上市384

三、企业应何地上市384

四、企业上市前准备384

第四节 集成电路企业IPO上市的规划实施386

一、上市费用规划和团队组建386

二、尽职调查及问题解决方案389

三、改制重组需关注重点问题393

四、企业上市辅导及注意事项396

五、上市申报材料制作及要求397

六、网上路演推介及询价发行399

第五节 企业IPO上市审核工作流程401

一、企业IPO上市基本审核流程401

二、企业IPO上市具体审核环节401

三、与发行审核流程相关的事项404

部分图表目录：

图表 1 集成电路按集成度高低分类27

图表 2 集成电路基本类别29

图表 3 集成电路行业产品及内在联系29

图表 4 中国集成电路产业主要政策措施一览表32

图表 5 全球集成电路产业分布图38

图表 6 2008-2016年全球半导体市场规模变化趋势图39

图表 7 2016年全球集成电路产业产值图谱39

图表 8 集成电路IDM商业模式40

图表 9 集成电路垂直分工商业模式41

图表 10 美国集成电路产业分布图42

图表 11 欧洲集成电路产业分布图44

- 图表 12 日本集成电路产业分布图46
 - 图表 13 韩国集成电路产业分布图48
 - 图表 14 台湾集成电路产业分布图51
 - 图表 15 集成电路产业链结构53
 - 图表 16 2008-2016年中国集成电路设计业销售收入增长趋势图57
 - 图表 17 中国集成电路设计主要企业59
 - 图表 18 中国集成电路设计业SWOT分析60
 - 图表 19 2008-2016年中国集成电路制造业销售收入增长趋势图63
 - 图表 20 中国集成电路制造行业主要企业64
 - 图表 21 中国集成电路制造业SWOT分析65
 - 图表 22 IDM模式企业业务流程66
 - 图表 23 2008-2016年中国集成电路封测业销售收入增长趋势图67
 - 图表 24 全球主要专业集成电路封装厂商68
 - 图表 25 中国集成电路封测行业主要企业69
 - 图表 26 中国集成电路封测业SWOT分析70
 - 图表 27 QFP封装技术主要产品指标73
 - 图表 28 晶圆级芯片尺寸封装与传统封装的区别77
 - 图表 29 Shellcase系列WLCSP和晶圆凸点封装的特征和应用领域比较78
 - 图表 30 2016年中国集成电路行业经济指标统计81
 - 图表 31 2016年中国集成电路行业前五省区企业数量排名82
 - 图表 32 2016年中国集成电路行业前五省区资产总计排名83
- 更多图表见正文……

详细请访问：<https://www.huaon.com/detail/303163.html>